



台積公司率先推出7奈米汽車設計實現平台

*優異的量產紀錄及獲得ISO 26262汽車安全標準認證的基礎矽智財
協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統、以及自動化駕駛的設計時程*

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年5月28日

台灣積體電路製造股份有限公司今（28）日宣布領先全球推出 7 奈米汽車設計實現平台（Automotive Design Enablement Platform, ADEP），協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統、以及自動化駕駛應用的設計時程。台積公司自 2018 年開始量產 7 奈米技術，擁有領先業界的良率學習與品質保證經驗，能夠提供滿足汽車應用日增的高度運算需求之先進製程，同時也符合嚴格的耐用性與可靠性要求。

台積公司汽車設計實現平台已獲得 ISO 26262 功能性安全標準的認證，涵蓋標準元件、通用型輸入輸出(GPIO)、以及 SRAM 基礎矽智財，皆奠基於台積公司多年的 7 奈米生產經驗，支援堅實的設計並獲取首次投片即成功。此外，台積公司基礎矽智財已通過 AEC-Q100 第一級規格的嚴格驗證，提供客戶多一層的品質保證。製程設計套件及第三方矽智財廠商的支援亦已到位，可協助客戶進一步集注在市場上推出差異化的產品。台積公司不僅穩健提供滿足汽車零件等級缺陷率的 7 奈米產能，同時也承諾支援車用產品的長久生命週期。

台積公司研究發展組織技術發展資深副總經理侯永清博士表示：「汽車應用向來要求最高的品質水準，隨著先進駕駛輔助系統及自動化駕駛的出現，強大且高效的運算能力變得不可或缺，以驅動人工智慧推理引擎進行道路與交通感測，進而協助駕駛迅速做出決定。台積公司處於獨特的優勢地位，擁有豐富的 7 奈米量產經驗與完備的設計生態系統，協助客戶釋放創新，首次投片即獲得成功，同時滿足市場上對於更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求。」



除了健全的汽車矽智財生態系統，台積公司晶圓廠取得 IATF 16949 認證，支援汽車產品的製造。台積公司提供汽車服務套件 (Automotive Service Package) 以支援晶圓製造，內建「零缺陷思維」 (Zero Defect Mindset) 進而強化管控使元件製造達到汽車零件等級的每百萬缺陷數 (DPPM) 目標，同時生產期間的安全投產專案 (Safe Launch Program) 也能夠確保成功推出新產品。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。

進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com